

EXPOSITION - CONFÉRENCES - ANIMATIONS

RF & Microwave

7^{ème}
édition

Le salon
des radiofréquences,
des hyperfréquences,
du wireless, de la CEM
et de la fibre optique

21 et 22 mars 2018

Paris Expo

Porte de Versailles

www.microwave-rf.com

En parallèle des salons

**Embedded
Systems**

MtoM
& Objets Connectés

**IoT
world**

Avec
ELECTRONIQUE



@Microwave_RF

INVITATION

En 2018, pas moins de **45 conférences réparties en 8 sessions** vous permettront de faire le point sur les dernières innovations technologiques : la simulation CEM et RF , l'IoT et la Radio, la Fiabilité des composants et systèmes électroniques Hyperfréquences, la CEM en Aéronautique, évolution des normes de CEM, les Antennes réalisées par impression 3 D , le RoF : Techniques et applications de la radio sur fibre, le GaN pour les applications hyperfréquences.

Plus de 70 exposants et partenaires vous présenteront leurs nouveautés dans les domaines de l'instrumentation, du test, des composants actifs et passifs, des logiciels de simulation et de conception, de la CEM, des antennes, des équipements, des systèmes et de la sous-traitance.

RF & Microwave se déroule en parallèle des salons MtoM & Objets Connectés Embedded Systems et IoT World. Votre badge vous donne accès à l'ensemble des manifestations.

PLANNING DES CONFÉRENCES

Mercredi 21 mars					
matin			après-midi		
SALLE 1	SALLE 2		SALLE 1	SALLE 2	
La simulation CEM et RF	Fiabilité des composants et Systèmes Electroniques Hyperfréquences		IoT et Radio	Fiabilité des composants et Systèmes Electroniques Hyperfréquences	

Jeudi 22 mars					
matin			après-midi		
SALLE 1	SALLE 2	SALLE 3	SALLE 1	SALLE 2	SALLE 3
La CEM en aéronautique	Les Antennes réalisées par impression 3D	Le GaN pour les applications hyperfréquences	Evolution des normes de CEM, foudre et médicale	RoF: Techniques et applications de la radio sur fibre	Le GaN pour les applications hyperfréquences

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Salle 1 - MERCREDI 21 MARS - matin

10h00 : Introduction aux conférences CEM et Radio organisées par l'AFCEM



La simulation CEM et RF

Président de session Jérôme Mollet - CST - Dassault Système Simulia

Les problématiques, les avancées ainsi que les perspectives qui peuvent être attendues pour demain de la simulation numérique dans les domaines de la CEM et de la RF seront exposés à partir de cas réels d'application.

10h15 : **Simulation numérique CEM en réseau : Présentation du projet collaboratif CSE (Cosimulation Système pour l'Electromagnétisme)**

Marco Klingler - PSA.

10h45 : **Apport de la Simulation Electromagnétique 3D pour la Compatibilité Radio Electrique (CRE)**

Olivier Roncière - DGA-MI.

11h15 : **Measurement and Simulation Link Applied to Antenna Placement Problems**

Lucia Scialacqua - Microwave Vision Group (présentation en Anglais).

Les conférences sont en accès libre vous pouvez vous préenregistrer sur www.microwave-rf.com

Programme mis à jour régulièrement sur www.microwave-rf.com

Les programmes sont édités sous réserves de modifications. Accès dans la limite des places disponibles.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Salle 1 - MERCREDI 21 MARS - après-midi

IoT et Radio

Président de session - Pascal Saguin - Adeunis.

Les réseaux IoT bas débits sont maintenant une réalité (LoRa, SIGFOX...) et permettent le déploiement des flottes de capteurs pour monitorer les infrastructures, les bâtiments et tout autre type d'application. Dans ce contexte, quelles sont les facteurs clés pour assurer de bons déploiements et garantir que les données arriveront bien sur les serveurs.

14h00 : Comment anticiper les problèmes sur les réseaux et capteurs, quels sont l'ensemble des éléments de la chaîne de la valeur IoT et comment les piloter pour garantir une qualité de service optimale.

- *JL Baudouin - Adeunis.*

14h30 : Comment les réseaux bas débits utilisés au niveau collecte peuvent être combinés avec du monitoring /supervision au niveau des serveurs clients pour mettre en place des mécanismes de suspicion de pannes.

Comment les réseaux bas débits peuvent être utilisés en complément de système haut débits pour remonter des informations quand la collecte d'information passe en mode dégradé. - *F. Pacull - Bag-Era*

15h00 : Comment réaliser un produit connecté à un réseau LoRa ? Cas pratique d'un des premiers déploiements LoRa et pièges à éviter. - *B. Diard - RTone.*

15h30 : Evolution des bandes de fréquences et de la recommandation 7003 dans le contexte IoT, la conformité : une des clés du déploiement en masse. - *Philippe Dunand - Aemc.*

Salle 2 - MERCREDI 21 MARS – journée



Fiabilité des composants et Systèmes Electroniques Hyperfréquences

Président de session - Philippe Eudeline - Thales Air Systems

Le programme de cette session est disponible sur le site : www.microwave-rf.com

Salle 1 - JEUDI 22 MARS - matin

10h00 : Introduction aux conférences CEM et Radio organisées par l'AFCEM



La CEM en aéronautique

Président de session - Patrice Foutrel - Safran Electronics & Defense

Développement de solutions CEM dans les architectures modulaires avionique, les présentations mettront en évidence la prise en compte des exigences normatives en présentant des cas concrets de réalisations et leurs problématiques associées.

10h15 : Caractérisation de la performance CEM des blindages à faible taux de couverture

Jérôme Genoulaz - Safran Electrical & Power (EWIS)

10h45 : Unusual interference scenario from windshield electrostatic charging

Bertrand Chatain - Airbus Helicopters

11h15 : La certification, les enjeux de la Foudre et de la CEM dans le domaine aéronautique

Fabrice Tristant - Dassault Aviation

11h45 : Robustesse CEM des liaisons de communications avioniques modulaires

Patrice Foutrel - Safran Electronics & Defense

Salle 2 - JEUDI 22 MARS - matin

Les Antennes réalisées par impression 3D

Président de session - Jean-Marie Floc'h - IETR

10h00 : Antenne large bande en impression 3D - *Jean-Marie Floc'h - IETR.*

10h30 : Antenne pour capteur à 24 GHz réalisée en partie en impression 3D - *Jean-Marie Floc'h - IETR*

11h00 : Antennes et composants associés en ondes millimétriques : profitons de l'impression 3D

Maria Garcia Viguera - IETR

11h30 : Propriétés des antennes réalisées en impression 3D par pulvérisation d'argent

Koen Staelens - Jet Metal.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES

Salle 1 - JEUDI 22 MARS - après-midi

Evolution des normes de CEM, foudre et médicale. Erreurs et pièges à éviter

Président de session - Philippe Dunand – Aemc.

- 14h00** : La protection foudre: les normes et la réalité du terrain
Gilles Delcourt - APEI
- 14h30** : Evolutions des exigences CEM médicales. Amendements en cours
Philippe Sissoko - Emitech
- 15h00** : Incohérences et erreurs de normes en CEM
Alain Charoy - Aemc.
- 15h30** : Atténuation d'un passe-bas (filtre, blindage) en impulsion longue. Erreur fréquente et méthode simple de prédiction
Michel Mardiguian - Expert CEM.

Salle 2 - JEUDI 22 MARS - après-midi

RoF: Techniques et applications de la radio sur fibre

Président de session François Magne – When AB

- 14h00** : Principe et applications de la radio sur fibre
François Magne - WHEN-AB
- 14h30** : Modélisation Comportementale des systèmes RoF
Jean-Luc Polleux - ESYCOM
- 15h00** : Liaisons et modules de transmission radio très large bande sur fibre optique
Dominique Lebrouster – VectraWave
- 15h30** : Multiplexage de radios sur fibre
Aurélien Boutin - Kylia
- 16h00** : Système MoRF, Produits et Economie
Philippe Chaussebourg BOWEN

Salle 3 - JEUDI 22 MARS - Journée

Le GaN pour les applications hyperfréquences

Président de session Jean-Claude de Jaeger - IEMN

- 10h00** : Problématique et perspective d'emploi du GaN dans les systèmes de défense
Francis DOUKHAN & François REPTIN - DGA
- 10h30** : Epitaxies GaN/SiC et GaN/Si de grand diamètre pour les applications 5G - *Marianne GERMAIN - EPIGAN*
- 11h00** : Nouvelles voies technologiques GaN/SiC pour la mesure de la température et l'amélioration de la dissipation thermique des HEMTs GaN - *Marie LESECCQ, Flavien COZETTE, Mahmoud ABOU DAHER, Mohamed-Reda IREKTI, Mohammed BOUCHERTA, Nicolas DEFRANCE, Yvon CORDIER & Jean-Claude DE JAEGER – IEMN, CNRS-Université de Lille, CRHEA, CNRS-Valbonne*
- 11h30** : Composants HEMT InAlGaN/GaN pour applications en bandes Ka et Q
Stéphane PIOTROWICZ, Olivier PATARD, Jean-Claude JACQUET, Piero GAMARRA, Christian DUA & Sylvain DELAGE - III-V lab
- 12h00** : Méthodes avancées de caractérisation et de modélisation des transistors HEMT GaN
Jean-Christophe NALLATAMBY & Raymond QUERE - XLIM, CNRS-Université de Limoges
- 12h30** : MMICs et Modules basés sur la technologie GaN pour les applications en communication et capteurs
Michael SCHLECHTWEIG – Fraunhofer Institute IAF (Germany)
- 14h00** : Le GaN chez Thales DMS : des circuits aux systèmes
Yves MANCUSO - Thales Systèmes Aéroportés
- 14h30** : Récents développements en technologie de puissance GaN/SiC pour applications hautes fréquences
Didier FLORIOT – UMS
- 15h00** : MMIC GaN / Si 100 nm: la solution front-end pour les systèmes mmW 5G
Marc ROCCHI, Fabien ROBERT, François LECOURT, Rémy LEBLANC & Peter FRIJLINK - OMMIC
- 15h30** : Quasi-MMIC HPA en package plastique de haute performance délivrant 60W en bande S
Zineb OUARCH, Maxime OLIVIER & Philippe EUDELIN - UMS - Thales Air Systems

Programme mis à jour régulièrement sur www.microwave-rf.com

ANIMATIONS

La Plateforme Carrières

Profitez de la plateforme carrières mise en place les 21 – 22 mars 2018 pour venir rencontrer des jeunes ingénieurs ou des experts dans les domaines de la RF , des Hyperfréquences, Télécommunications, Fibre Optique, Software,....

Vous êtes une société et vous recherchez des profils spécialisés car vous avez des offres d'emploi à pouvoir, n'hésitez pas à venir les déposer sur la plateforme carrières en plusieurs exemplaires sur le salon.

Vous êtes jeunes ingénieurs à la recherche d'un emploi, venez déposer plusieurs copies de votre CV sur notre plateforme durant les 2 journées du salon.

Animation sur le stand des Radioamateurs à RF & Microwave 2018 :

Comme les années précédentes les radioamateurs seront présents au salon RF & Microwave.

Découvrez ARDUINO et ses applications chez les radioamateurs.

Atelier d'initiation pour les débutants :

Utilisation d'une méthode d'initiation rapide pour réaliser un premier programme en 15 minutes.

Pilotage des circuits intégrés modernes (par protocole I2C, SPI sur des oscillateurs, synthétiseurs, émetteur-récepteur intégré, etc...)

www.microwave-rf.com

Liste des exposants & partenaires Au 18/01/2018

AB2E CEM & THERMAL MANAGEMENT • ACC INGENIERIE & MAINTENANCE • ACTUTEM
• ADVANTEN • AFCEM • AMD GROUP • AQUISYS • AR FRANCE • ABS TECHNICS BVBA •
ATLANTEC • AUREL SPA • COTELEC • CST - DASSAULT SYSTÈME SIMULIA • DICONEX -
DELTA OHM • EENEWS - MICROWAVE ENGINEERING EUROPE • ELECTRONIQUE COMPOSANTS
& INSTRUMENTATION • ELECTRO-SOLUTIONS • ELECTRONIC SPECIFIER • ELECTRONIQUES
• ELECTRONIQUE MAG • EM TEST • EMC PARTNER • ENVIRONNEMENTAL ENGINEERING •
EUROMC • ESSAIS ET SIMULATIONS • EVERYTHING RF • EXOCIS • FANKONIA GMBH •
FI SCIENCE • GERAC • GTID • IFOTEC • INOVEOS • KEMTRON • LMDI • LUXONDES •
MATECH • MESURES • MESURES & TESTS • MICROTEST • MICROWAVE JOURNAL •
MILEXIA • MSE - MICRO SYSTEMS ENGINEERING GMBH • NATIONAL INSTRUMENTS • NEXIO
• RF GLOBALNET • ROHDE & SCHWARZ • SALIES • SEE - REE • SOLIANI EMC • SPHEREA /
NOISE XT • STACEM • TECHNIWAVE • TEKTRONIX FRANCE • WÜRTH ELEKTRONIK • ...

Liste des exposants mise à jour sur : www.microwave-rf.com



**Demandez dès maintenant
votre badge visiteur
Microwave & RF sur :**

www.microwave-rf.com

**il vous donne également
accès aux salons :**

**Les 21 et 22 mars
2018
PARIS EXPO
PORTE DE
VERSAILLES**

**Embedded
Systems**

Systèmes et logiciels embarqués
Affichage, visualisation, conception et
test de Systèmes Electroniques - Hall 5.3

**MtoM
& Objets Connectés**

Design, conception, réalisation
MtoM et Objets communicants- Hall 5.3

**CLOUD
COMPUTING
WORLD EXPO**

L'événement leader du Cloud
en France - Hall 5.2

**SOLUTIONS
DATACENTER
MANAGEMENT**

L'événement leader du Datacenter en
France - Hall 5.2

**IoT
world**
WHERE CONNECTED THINGS MEET BUSINESS

Where connecting things meet
business - Hall 5.2

INFOS PRATIQUES

**RF &
Microwave**

Paris Expo-Porte de Versailles
1, place de la Porte de Versailles
75015 Paris

Pavillon 5.3
Mercredi 21 Mars
9h00 - 18h00
Judi 22 mars
9h00 - 17h30

MOYENS D'ACCES :

• **La ligne de métro n°12**
(Mairie d'Issy / Porte de la Chapelle)
Station Porte de Versailles- Sortie :
Paris Expo.

• **La ligne de tramway T3**
Station Porte de Versailles

• **Lignes de Bus**
39 et 80 Station Porte de Versailles

• **En voiture**
Boulevard Périphérique extérieur : Sortir
Porte de Versailles- Pont de Sèvres. Au
rond-point à gauche avenue de la Porte
de Sèvres, première à droite « boulevard
Victor » jusqu'à la place de la Porte de
Versailles.

Boulevard Périphérique intérieur : Sortie
« Porte de Sèvres ». Au feu prendre à
droite « Avenue de la Porte de la Porte
de Sèvres » puis première à droite
« boulevard Victor » jusqu'à la Place de
la Porte de Versailles.

• Parkings à proximité

Parking Aquaboulevard ,
Parking Indigo Mairie d'Issy,
Parking Indigo Citroën Cévennes.

• En train



Sur simple demande à l'adresse :
s.lefebvre@infoexpo.fr, vous avez la
possibilité de bénéficiez de fichets de
réduction SNCF de 20% sur les billets
aller-retour. Pour ce faire, indiquez-
nous votre adresse postale et la
quantité souhaitée.

N.B. : Cette réduction est valable sur
toutes les lignes à tarification SNCF, en
1ère et 2ème classe. Vous trouverez le
détail des conditions d'utilisation au
verso des fichets.

• En avion



Vos billets d'avion au meilleur prix
Réductions sur une très large gamme
de tarifs publics. Code Identifiant à
communiquer lors de la réservation :
32529 AF - sur :
www.globalmeetings-airfranceklm.com

www.microwave-rf.com

Organisation



Tél : 01 44 39 85 00



@Microwave_RF